

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性亦不承擔任何責任。對於準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BASiC Semiconductor Co., Ltd.
深圳基本半導體股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9971)

**(1) 建議採納H股股權激勵計劃；
及
(2) 建議修訂公司章程相關事宜**

(一) 建議採納H股股權激勵計劃

緒言

於2026年8月11日，董事會已決議建議採納H股股權激勵計劃。本公司將召開股東會，以尋求股東批准（其中包括）採納H股股權激勵計劃，並授權董事會及／或獲董事會授權人士處理H股股權激勵計劃相關事宜。

H股股權激勵計劃不涉及授出本公司的新股份或新股份的購股權。然而，H股股權激勵計劃構成上市規則第17章之涉及現有股份的股份計劃，並須遵守上市規則第17.12條的適用披露規定。因此，根據上市規則，採納H股股權激勵計劃無須經股東批准。然而，根據公司章程，H股股權激勵計劃及相關事宜須經股東於臨時股東會批准，方可作實。

H股股權激勵計劃的主要條款包括但不限於：

目的

H股股權激勵計劃的目的為向合資格參與者提供獲取本公司股本權益的機會，並激勵合資格參與者致力於提升本公司及其股份的價值，促進本集團長遠發展，惠及本集團及全體股東。預期H股股權激勵計劃將為本集團提供靈活的途徑，用於聘用、留任、激勵、獎勵、補償及／或提供福利予合資格參與者。

股份來源

於H股股權激勵計劃下的股份來源，應由受託人（代表合資格參與者及就其利益行事）按照本公司指示及H股股權激勵計劃規則的相關條文通過以下方式持有：於二級市場以計劃資金按當時市場價格進行場內及／或場外交易取得。

合資格參與者

有權參與計劃的合資格參與者包括任何僱員參與者、服務提供者及關聯實體參與者。

董事會及／或獲董事會授權人士可根據H股股權激勵計劃規則選擇任何合資格參與者作為H股股權激勵計劃的承授人。

計劃限額

除非股東批准進一步更新計劃限額或根據上市規則取得股東批准，本集團不得進一步授出任何獎勵，以致本集團於採納日期後根據H股股權激勵計劃（不包括根據相關計劃規則已失效的獎勵）涉及的獎勵股份的總數超過股東批准計劃限額（即於採納日期已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%）。於本公告日期，本公司已發行股本包括304,289,725股每股面值人民幣0.20元的股份，其中包括287,534,442股H股及16,755,283股內資股。經股東批准並假設由本公告日期至採納日期期間已發行股份概無變動，計劃限額將為30,428,972股股份。

由於H股股權激勵計劃的合資格參與者範圍將擴大至包括服務提供者，董事會認為，根據上市規則第17.03B(2)條，於計劃限額內設立服務提供者分項限額實屬恰當。除非股東批准進一步更新服務提供者分項限額，或根據上市規則取得股東批准，否則本集團不得向服務提供者進一步授出任何獎勵，以致本集團於採納日期後根據H股股權激勵計劃及本集團採納的其他股份計劃授出的所有獎勵（不包括根據相關計劃規則已失效的獎勵）涉及的獎勵股份的股份總數超過股東批准服務提供者分項限額當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的1%。於本公告日期，本公司已發行股本包括304,289,725股每股面值人民幣0.20元的股份，其中包括287,534,442股H股及16,755,283股內資股。經股東批准並假設由本公告日期至採納日期期間已發行股份概無變動，服務提供者分項限額將為3,042,897股份。

獎勵股份的授予及歸屬

在符合H股股權激勵計劃條款及條件的前提下，董事會及／或獲董事會授權人士可按其全權酌情決定，並按其認為適當的條款及條件，按購買價格向任何合資格參與者授出獎勵股份，而相關購買價格由董事會及／或獲董事會授權人士決定，並載於獎勵函件。凡向本公司董事或高級管理層授出獎勵股份，應先經薪酬與考核委員會及董事會批准。此外，凡向本公司任何董事、最高行政人員或主要股東（或彼等各自的聯繫人）授出獎勵股份，須事先獲得本公司獨立非執行董事的批准。於董事會及／或獲董事會授權人士決定向任何承授人授出獎勵股份後，本公司須向該承授人發出獎勵函件，其中載列授出詳情，包括但不限於承授人的姓名及身份、授出的獎勵股份數目、歸屬準則及條件、歸屬開始日期、歸屬日期、購買價格、獎勵股份失效及追索機制（如有），以及由董事會及／或獲董事會授權人士決定且不與H股股權激勵計劃相抵觸的其他條款及條件。

在符合所有適用法律、規則或法規的前提下，董事會及／或獲董事會授權人可決定根據H股股權激勵計劃向各承授人授出的獎勵股份歸屬準則、條件及歸屬期。除董事會另有決議外，任何授出的獎勵股份的歸屬期不得少於自授出日期起計（包括該日）十二個月。

計劃期限及終止

董事會未根據H股股權激勵計劃規則決定提前終止的前提下，H股股權激勵計劃於計劃期（即自採納日期起計十年(10)年）內有效並具效力，期滿後不再授出額外獎勵股份。倘於H股股權激勵計劃期滿時仍有已授出但尚未歸屬的獎勵股份，則H股股權激勵計劃將延長至該等獎勵股份完成歸屬為止。

(二) 建議修訂公司章程相關事宜

於2026年8月11日，董事會已議決及批准（其中包括）：(i)建議修訂公司章程；及(ii)提請股東會授權董事會，並由董事會進一步授權本公司董事長或其進一步授權的其他人士辦理修訂公司章程涉及的相關工商變更登記、備案等事宜（「授權」）。

茲提述本公司日期為2026年7月7日的公告，內容有關最終發售價及配發結果，涉及已發行股本總額為304,289,725股，其中包括287,534,442股H股及16,755,283股未上市股份（內資股）。因此本公司註冊資本及股份總數分別變更為人民幣6,085.7945萬元以及30,428.9725萬股。董事會建議對公司章程作出下列相關修訂：

公司章程條款序號	修訂前公司章程內容	修訂後公司章程內容
第四條	公司於2025年11月26日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）備案並於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）核准，首次公開發行境外上市外資股（H股）[●]股，於[●]年[●]月[●]日在香港聯交所主板上市。	公司於2025年11月26日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）備案並於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）核准，首次公開發行境外上市外資股（H股） <u>[●]27,386,200股，同時260,148,242股境內未上市股份通過全流通的方式轉換為H股</u> ，前述H股於[●]年[●]月[●]日 <u>2026年7月8日</u> 在香港聯交所主板上市。
第七條	公司註冊資本為人民幣[●]萬元。	公司註冊資本為人民幣[●] <u>6,085.7945</u> 萬元。
第二十二條	公司已發行的股份數為[●]萬股，全部為普通股。	公司已發行的股份數為[●] <u>30,428.9725</u> 萬股，全部為普通股。

除建議修訂外，公司章程的其他條款保持不變。建議修訂公司章程以中文編製，中英文版如有歧義，概以中文版為準。

建議修訂公司章程須待股東於臨時股東會上通過特別決議案批准。

臨時股東會

本公司將召開臨時股東會，以審議及酌情批准（其中包括）(i)建議採納H股股權激勵計劃；(ii)建議修訂公司章程。

一份載有有關（其中包括）(i)建議採納H股股權激勵計劃；(ii)建議修訂公司章程；及(iii)召開臨時股東會通告的通函，將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.basicsemi.com)，並於適時寄發予股東（根據股東的要求）。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「採納日期」	指	本公司採納H股股權激勵計劃的日期，即股東於臨時股東會上通過批准及採納H股股權激勵計劃的特別決議案之日期
「章程」或「公司章程」	指	本公司經不時修訂的公司章程
「獎勵」	指	董事會及／或其獲董事會授權人士根據H股股權激勵計劃向承授人授出的獎勵，獎勵可根據H股股權激勵計劃條款以獎勵股份形式或現金支付獎勵股份的實際售價形式歸屬
「獎勵函件」	指	本公司以董事會及／或獲董事會授權人士不時決定的形式向各承授人發出的函件，列明授出詳情，包括但不限於承授人的姓名及身份、授出的獎勵股份數目、歸屬準則及條件、歸屬開始日期、歸屬日期、購買價格、獎勵股份失效及追索機制（如有），以及由董事會及／或獲董事會授權人士決定且不與H股股權激勵計劃相抵觸的其他條款及條件
「獎勵股份」	指	根據H股股權激勵計劃以獎勵授出的H股
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，除非內容或文義另有所指，僅就本公告而言，不包括中華人民共和國台灣、香港及澳門特別行政區
「本公司」	指	深圳基本半導體股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股已於聯交所（股份代號：9971）上市
「董事」	指	本公司董事

「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境內未上市股份
「臨時股東會」	指	本公司計劃於2026年8月28日（星期五）下午二時三十分於中國廣東省深圳市坪山區龍田街道老坑社區光科一路6號青銅劍科技大廈1棟12樓會議室召開的2026年第一次臨時股東會，或其任何續會
「合資格參與者」	指	就H股股權激勵計劃而言，屬於(i)僱員參與者、(ii)關聯實體參與者及(iii)服務提供者中任何一者的任何個人或公司實體（視乎情況而定）
「僱員參與者」	指	本公司及／或其任何附屬公司的董事、監事及僱員（無論全職或兼職僱員）（包括以根據H股股權激勵計劃獲得獎勵作為與該等公司訂立僱傭合同的動機的人士）
「承授人」	指	根據H股股權激勵計劃之條款接納授出獎勵的合資格參與者「本集團」指本公司及其附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股股權激勵計劃」	指	建議由本公司採納的H股股權激勵計劃，須經股東於臨時股東會通過並批准
「H股股權激勵計劃規則」	指	H股股權激勵計劃的規則（以其目前或任何經修訂形式）
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境外上市股份，並已於聯交所上市買賣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「購買價格」	指	就獎勵股份而言，每股H股的購買價格，由董事會及／或獲董事會授權人士於授出獎勵股份時釐定
「關聯實體」	指	本公司的控股公司、同系附屬公司或聯營公司

「關聯實體參與者」	指	關聯實體的董事、監事及僱員（無論全職或兼職僱員）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「計劃限額」	指	根據本公司所有股份計劃經股東批准授出的獎勵的限額，不得超過股東批准計劃限額當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%
「服務提供者」	指	任何於日常及一般業務過程中向本集團提供持續且經常、符合本集團長期發展利益的服務的個人（自然人或公司實體）
「股東」	指	股份持有人，包括內資股股東及H股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「信託」	指	根據信託契據設立的信託
「信託契據」	指	公司與受託人根據H股股權激勵計劃將訂立的信託契據
「受託人」	指	本公司就信託委任的受託人
「%」	指	百分比

承董事會命
 深圳基本半導體股份有限公司
 董事長
 汪之涵博士

中國深圳，2026年8月11日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事汪之涵博士、和巍巍博士、傅俊寅先生及閆瑞女士；及(ii)獨立非執行董事李居平先生、葉翔先生及王蘇生先生。